

证券代码：600353

证券简称：旭光电子

公告编号：2026-007

成都旭光电子股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1735号)核准，成都旭光电子股份有限公司(以下简称“公司”)以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)48,287,971股，发行价格为人民币11.39元/股，募集资金总额为人民币549,999,989.69元，扣除各项发行费用(不含税)人民币15,495,898.79元，实际募集资金净额为534,504,090.90元。

上述募集资金已于2022年9月5日全部到位，已经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(川华信验(2022)第0084号)。

(二) 前次募集资金使用及存放情况

2022年9月5日，本公司收到前次募集资金536,199,989.69元，并存放于公司募集资金专户。截至2025年10月31日，募集资金账户存储情况如下：

| 募集资金存放银行名称 | 银行账号 | 初始存放金额(元) | 余额(元) |
|----------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 成都银行股份有限公司犀浦支行 | 1001300001054898 | 120,000,000.00 | 59,453.75 |
| 中信银行股份有限公司成都锦江支行 | 8111001012800854425 | 120,000,000.00 | 32,213,661.68 |
| 中国工商银行股份有限公司成都马超西路支行 | 4402943029100134835 | 296,199,989.69 | 1,669.80 |

| 募集资金存放银行名称 | 银行账号 | 初始存放金额(元) | 余额(元) |
|------------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行 (注2) | 801101001316867745 | | 19,136,807.30 |
| 合 计 | | 536,199,989.69 | 51,411,592.53 |

注1：中信银行股份有限公司成都银河王朝支行已更名为中信银行股份有限公司成都锦江支行；

注2：电子封装陶瓷材料扩产项目的实施主体为公司下属二级子公司宁夏北瓷新材料科技有限公司，公司以使用募集资金向其提供借款的方式实施电子封装陶瓷材料扩产项目，并与该公司、保荐机构及广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行共同签署了《募集资金四方监管协议》，根据协议约定，前述借款资金存入在北滘支行设立的募集资金专户，实行集中监管。

截至2025年10月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

| 项目 | 金额(万元) |
|------------------|------------------|
| 募集资金总额 | 55,000.00 |
| 减：发行费用 | 1,549.59 |
| 募集资金净额 | 53,450.41 |
| 减：置换预先投入募集资金金额 | 12,806.19 |
| 减：直接投入募投项目金额 | 36,362.85 |
| 加：利息收入及理财收益减除手续费 | 859.79 |
| 募集资金余额 | 5,141.16 |

二、前次募集资金使用情况

截至2025年10月31日，前次募集资金使用情况对照表详见本公告附件1。

三、前次募集资金变更情况

(一) 募集资金投资项目延期情况

2024年4月26日，公司第十届董事会第二十五次会议及第十届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2022年非公开发行募投项目延期的议案》，由于国内半导体市场的逐步升级，对相关产品的质量和性能也提出更高的要求，同时，HTCC及氮化硅基板涉及的制造工艺复杂，并且生产验证周期较长。因此，为保障募投项目质量，维护公司及全体股东利益，确保产品质量与性能稳定，更好的服务于客户，后续仍需更多时间进行设计优化和工艺调试等技术攻关工作，公司将“电子封装陶瓷材料扩产项目”及“电子陶瓷材料产业化项目（一期）”达到预定可使用状态的预计时间延期至2024年12月。

(二) 募集资金投资项目变更情况

2024年11月11日，公司第十一届董事会第四次会议及第十一届监事会第四次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》，保荐机构对此事项发表了明确同意的核查意见。2024年11月27日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》。

公司将“电子陶瓷材料产业化项目(一期)”募集资金投入金额减少6,736.97万元，减少部分调整至“电子封装陶瓷材料扩产项目”，并相应增加“电子封装陶瓷材料扩产项目”的投资总额。募集资金变更的金额占募集资金承诺投资金额的12.60%。“电子封装陶瓷材料扩产项目”及“电子陶瓷材料产业化项目(一期)”达到预定可使用状态的日期再次延期至2025年12月。

上述募集资金投资项目的调整及延期均系基于公司现有资源、发展规划和市场环境进行的正常调整及延期，未构成募投项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

上述募集资金投资项目变更的具体情况如下：

单位：万元

| 项目名称 | 变更前 | | 变更后 | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 投资总额 | 拟投入募集资金总额 | 投资总额 | 拟投入募集资金总额 |
| 电子封装陶瓷材料扩产项目 | 22,187.42 | 13,670.86 | 36,925.80 | 20,407.83 |
| 电子陶瓷材料产业化项目(一期) | 41,464.83 | 31,979.55 | 41,464.83 | 25,242.58 |
| 补充流动资金 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 |
| 合计 | 71,452.25 | 53,450.41 | 86,190.63 | 53,450.41 |

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至2025年10月31日，公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况如下：

单位：万元

| 项目名称 | 承诺募集资金投资总额 | 实际投入募集资金总额 | 差异金额 |
|--------------|------------|------------|-----------|
| 电子封装陶瓷材料扩产项目 | 20,407.83 | 18,506.02 | -1,901.81 |

| 项目名称 | 承诺募集资金投资总额 | 实际投入募集资金总额 | 差异金额 |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 电子陶瓷材料产业化项目（一期） | 25, 242. 58 | 22, 863. 02 | -2, 379. 56 |
| 补充流动资金 | 7, 800. 00 | 7, 800. 00 | - |
| 合计 | 53, 450. 41 | 49, 169. 04 | -4, 281. 37 |

差异的原因：

1、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。

2、募投项目结项时，存在工程设备尾款、质保金等款项尚未支付，主要原因系该等合同尾款支付时间周期较长。

四、前次募集资金投资项目先期投入项目及置换情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，本次募集资金到位前，本公司及实施募投项目的子公司宁夏北瓷新材料科技有限公司（以下简称“宁夏北瓷”）根据募投项目进展情况使用自筹资金进行预先投入。自2022年1月21日至2022年9月23日止，本公司及宁夏北瓷以自筹资金预先投入募集资金投资项目合计人民币12, 806. 19万元。截至2022年9月23日本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为人民币148. 34万元。预先投入募投项目及预先支付的发行费用合计12, 954. 52万元。

2022年9月28日，公司第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第九次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计12, 954. 52万元，上述事项已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了《关于成都旭光电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（川华信专（2022）第0631号）。

五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本公告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金用于永久补充本公司流动资金7,800.00万元，使本公司业务规模进一步扩大、公司综合竞争力得到提高，募集资金投资项目未承诺实现的经济效益，也无法单独核算。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

1、电子封装陶瓷材料扩产项目

一是市场竞争日益激烈，产品价格未达预期。近年来，国内氮化铝产业投资规模不断扩大以及需求端对低成本的诉求，产品销售价格与预测价格差异较大。二是大规模扩产后，良品率未达预期。由于氮化铝大规模扩产以及采用连续炉(国内首台)大规模生产，设备调试、工艺重新摸索、产品进行验证等，导致前期良品率未达预期，造成生产成本上升。三是加大对可研报告预期外的新产品研发投入。项目执行期间，由于市场环境、技术趋势及客户需求发生了快速而显著的转变，新的技术路径与细分应用场景不断涌现，并展现出潜在的市场空间；为把握发展机遇、构建面向未来的产品组合，降低因产品线单一可能带来的长期风险，公司经过审慎评估，决定在确保原定项目顺利推进的同时，新增230W/m.k以上高导热氮化铝和550MPa以上高抗弯氮化铝及其适配粉体的研发投入。该项新增研发投入也对实际收益与预期收益之间的差距产生了一定影响。

2、电子陶瓷材料产业化项目（一期）

一是市场竞争日益激烈，产品销售价格未达预期。近年来，国内氮化铝产业投资规模不断扩大以及需求端对低成本的诉求，产品销售价格与预测价格差异较大。二是大规模扩产后，良品率未达预期。由于氮化铝大规模扩产以及采用连续炉(国内首台)大规模生产，设备调试、工艺重新摸索、产品进行验证等，导致前期良品率未达预期，造成生产成本上升。三是加大对可研报告预期外的新产品研发投入。项目执行期间，由于市场环境、技术趋势及客户需求发生了快速而显

著的转变，新的技术路径与细分应用场景不断涌现，并展现出潜在的市场空间；为把握发展机遇、构建面向未来的产品组合，降低因产品线单一可能带来的长期风险，公司经过审慎评估，决定在确保原定项目顺利推进的同时，新增230W/m.k以上高导热氮化铝和550MPa以上高抗弯氮化铝及其适配粉体的研发投入。该项新增研发投入也对实际收益与预期收益之间的差距产生了一定影响。四是氮化硅项目投资进度不及预期。氮化硅项目规划中，其原粉计划从国内采购或者进口，由于国内原粉性能指标未完全成熟，导致项目整体实施有所延后。此情况直接影响了电子陶瓷材料产业化项目（一期）的预期销售收入，涉及金额17,150.40万元，从而对预期收益造成一定影响。

募集资金投资项目累计实现的收益与承诺的累计收益的差异情况详见本公司附件2。

六、闲置募集资金的使用

（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年10月31日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年9月28日公司召开的第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第九次会议及2022年10月14日召开的2022年第二次临时股东大会通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元（含）的部分闲置募集资金及不超过1.15亿元（含）的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2023年9月22日召开的公司第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十六次会议及2023年10月13日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本公司使用闲置募集资金进行现金管理，均已在前述授权期限内归还至募集资金账户。截至2025年10月31日，无使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

七、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

2025年11月24日，公司第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第九次会议审议并通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目“电子封装陶瓷材料扩产项目”及“电子陶瓷材料产业化项目（一期）”予以结项，并将节余募集资金5,141.16万元永久补充流动资金。此后，公司于2025年12月3日、8日、9日、10日分别从四个募集资金专户转出节余募集资金共计5,144.48万元（与结项时金额的差异主要系结项目至实际转出日期间产生的利息收入），并同步完成了相关募集资金专户的销户手续。

八、前次募集资金使用的其他情况

公司将前次募集资金实际使用情况与各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容进行逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2026年2月4日

● 上网公告文件

会计师事务所出具的鉴证报告

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

单位:万元

| 募集资金总额: | | | 53,450.41 | | | 已累计使用募集资金总额: | | | 49,169.04 | |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------------|
| 变更用途的募集资金总额: | | | 6,736.97 | | | 各年度使用募集资金总额: | | | | |
| | | | | | | 2022年: | | | 28,474.73 | |
| | | | | | | 2023年: | | | 6,980.81 | |
| 变更用途的募集资金比例: | | | 12.60% | | | 2024年: | | | 6,075.45 | |
| | | | | | | 2025年1-10月: | | | 7,638.05 | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | | |
| 1 | 电子封装陶瓷材料扩产项目 | 电子封装陶瓷材料扩产项目 | 13,670.86 | 20,407.83 | 18,506.02 | 13,670.86 | 20,407.83 | 18,506.02 | -1,901.81 | 2025年10月 |
| 2 | 电子陶瓷材料产业化项目(一期) | 电子陶瓷材料产业化项目(一期) | 31,979.55 | 25,242.58 | 22,863.02 | 31,979.55 | 25,242.58 | 22,863.02 | -2,379.56 | 2025年10月 |
| 3 | 永久补充流动资金 | 永久补充流动资金 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | - | - |
| 合计 | | | 53,450.41 | 53,450.41 | 49,169.04 | 53,450.41 | 53,450.41 | 49,169.04 | -4,281.37 | - |

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位:万元

| 实际投资项目 | | 截止日投资项目 累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年及一期实际效益 | | | | 截止日 累计实现效 益 | 是否达到 预计效益 |
|--------|-----------------|--|--|-------------|---------|-----------|------------------|-------------------|--------------|
| 序号 | 项目名称 | | | 2022 年度 | 2023 年度 | 2024 年度 | 2025 年 1-10 月 | | |
| 1 | 电子封装陶瓷材料扩产项 | 氮化铝粉体的产能利用率为 88.03%; 基板及结构件的产能利用率为 93.36%。 | 2024 年实现净利润 1,314.66 万元, 2025 年 1-10 月实现净利润 4,717.67 万元。 | 不适用 | 不适用 | -1,773.10 | -1,743.08 | -3,516.18 | 否 |
| 2 | 电子陶瓷材料产业化项目（一期） | 基板及结构件的产能利用率为 75.90% | 2024 年实现净利润 1,789.69 万元, 2025 年 1-10 月实现净利润 5,153.86 万元。 | 不适用 | 不适用 | -428.47 | -423.26 | -851.73 | 否 |
| 3 | 永久补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

注 1: 截止日投资项目累计产能利用率是指 2024、2025 年 1-10 月的实际产量之和与预计产量之和之比。

注 2: 电子封装陶瓷材料扩产项目于 2025 年 10 月 31 日达到预定可使用状态, 2024 年、2025 年 1-10 月氮化铝粉及氮化铝基板及结构件生产线陆续投产使用。

注 3: 电子陶瓷材料产业化项目（一期）于 2025 年 10 月 31 日达到预定可使用状态, 2024 年、2025 年 1-10 月氮化铝基板及结构件生产线陆续投产使用。

注 4: 如本公告“五、(二)”所述, 补充流动资金实现的经济效益无法单独核算, 也未承诺经济效益。

注 5: 因电子封装陶瓷材料扩产项目、电子陶瓷材料产业化项目（一期）预计于 2027 年达产, 故未计算披露项目所得税后内部收益率。